

<AsiaNet> CMD, SPEL 과 합작투자계약 체결

(밀피터스<미 캘리포니아주> AsiaNet=연합뉴스)

새로운 생산라인은 앞으로 2 개 분기내에 인증을 받고 운영에 들어갈 것으로 예상된다

캘리포니아 마이크로 디바이시스(California Micro Devices: CMD)(Nasdaq: CAMD)는 SPEL 반도체회사의 LMP(Leadless Molded Package) 제품라인 생산능력을 확대하고, 새로 추가된 2 종류의 소형 프로파일 패키지들에 대한 지원을 추가하기 위해서 SPEL 과 합작투자계약을 체결했다고 24 일 발표했다. 캘리포니아 마이크로 디바이시스는 추가 제품라인을 지원하기 위한 생산능력 확대에 필요한 약 775 만달러의 합작투자액 가운데 약 220 만달러를 출연할 것이다.

포터블 미디어 플레이어, MP3 플레이어, 디지털 카메라 및 캠코더 같은 박형(Thin) 모바일 핸드셋과 소형 포터블 기기들의 인기상승에 따라 소형 프로파일과 무연 패키지로 된 당사의 모바일 보호제품들에 대한 수요는 급증하고 있다. 성장하고 있는 이 모바일 보호시장부문 진출을 강화하고 있는 캘리포니아 마이크로 디바이시스는 SPEL 과 계약을 체결함으로써 조립생산 능력을 중요하고도 비용 효과적으로 확장할 수 있게됐다. 2 개 신규 라인인 TLMP 와 uTLMP 패키지를 사용하는 당사의 제품들을 위한 조립생산 능력을 제공할 것이다.

CMD 의 로버트 V. 디킨슨 사장겸 CEO 는 "SPEL 의 기술과 제조능력은 당사의 모바일 핸드셋 보호제품들을 최소 규모의 풋프린트와 초소의 프로파일로 패키지 하기 위한 당사의 전략을 보완해준다. 우리는 금년에 새로운 LMP 라인을 설치하기 위해 SPEL 과 협력하기 때문에 SPEL 과의 관계를 더욱 확대해 나가기를 기대한다"고 말했다.

SPEL 반도체회사 소개

SPEL 반도체회사(SPEL Semiconductor Limited)는 인도에 있는 원스톱 턴키방식의 웨이퍼 분류, IC 조립 및 테스트를 위한 주요 하도급업체이다. 1988 년에 설립됐으며 인도의 첸나이에 본사가 있는 SPEL 은 1988 년부터 1994 년까지 국내시장에 서비스를 제공했다. 국내에서 실적을 쌓은 SPEL 은 1995 년부터는 더욱 까다로운 해외시장에 주의를 돌리기 시작했다. SPEL 은 그 이래로 지난 10 여 년 간 실리콘밸리와 세계 다른 지역들에 서비스를 제공해오고 있다. 자세한 정보는 www.spel.com 을 통해 조회할 수 있다.

캘리포니아 마이크로 디바이시스 회사설명

캘리포니아 마이크로 디바이시스(California Micro Devices Corporation)는 모바일 핸드셋, 디지털 가전제품 및 개인용 컴퓨터 시장에 특정용도 아날로그 반도체와 혼합신호 반도체 제품들을 공급하는 주요 기업 이다. 당사가 제공하는 주요 제품들은 모바일 핸드셋을 비롯해서, 디지털 TV 와 개인용 컴퓨터 같은 디지털 가전제품, 그리고 모바일 핸드셋 디스플레이를 위한 아날로그와 혼합신호용 집적회로(IC)를 포함한다. 당사와 제품에 대한 자세한 정보는 웹사이트 www.cmd.com 을 통해 조회할 수 있다.

본 보도자료에 포함된 모든 내용들은 역사적 사실이 아닌 내용을 제외하고 1995 년 증권인사소송개혁법 중 면책조항에 따라 작성된 향후예상설명에 해당한다. 향후예상설명에 미래의 성과나 결과를 보장하는 것이 아니다. 그 대신 향후예상설명에 현재의 기대치, 추산, 믿음, 가정, 목적 및 목표를 기초로 한 것이며,

예측하기 어려운 불확실성들을 내포하고 있다. 따라서 실제결과는 향후예상설명에서 언급된 내용과는 실질적으로 다를 수도 있다.

향후예상설명은 할 것이다, 할 생각이다, 기대한다, 할 계획이다, 믿는다, 예상한다, 추정한다와 같은 단어들의 사용에 의해 종종 확인될 수 있다. 본 보도자료에서 언급된 향후예상설명 가운데는 SPEL의 생산능력 확장비용이 약 770만달러에 이를 것이라는 언급, 박형 모바일 핸드셋과 그 밖의 소형 기기들을 위한 시장에 당사가 모바일 보호기기 진출을 확대할 것이라는 언급, SPEL이 2개 조립라인을 성공적으로 완료하고 이들 라인이 앞으로 2개 분기 동안에 인증을 받고 운영에 들어갈 것이라는 언급, SPEL이 TLMP와 uTLMP 패키지의 비용 효과적인 생산업체가 될 것이라는 언급, 당사 모바일 핸드셋 보호제품들을 최소 규모의 풋프린트와 최소의 프로파일로 패키지 하기 위한 당사의 전략 등을 포함한다. 이러한 향후예상설명은 미래에 대한 당사의 추정과 평가에 기초한 것으로서, 사실이거나 사실이 아닐 수도 있으며, 많은 위험과 불확실성들을 내포하고 있다. 이러한 위험과 불확실성들 가운데는 SPEL의 LMP 조립 라인이 추정치 보다 더 비싼 장비가 필요하거나 건설비용이 초과할 수도 있는 가능성, 당사 모바일 보호기기들의 설계된 성능이 고객들의 요구사항들을 만족시킴으로써 이들이 자신들의 제품에 당사 기기를 계속해서 설계할지의 여부, 당사 기기들이 고객들의 설계 사양대로 성능을 발휘할지의 여부, 경쟁사들이 당사 기기보다 낮은 가격에 기기를 출시함으로써 당사가 시장점유율을 상실할지의 여부, 노동쟁의, 정부승인 혹은 금융상의 어려움으로 조립생산라인 완공이 지연 혹은 저해될지의 여부, SPEL이 예상외의 비용이나 경비발생 또는 기술적 어려움에 봉착해 비용 효과적인 패키지 생산업체가 될 수 없을 가능성, 당사가 설계문제에 봉착하거나 SPEL이 최소 규모의 풋프린트와 최소의 프로파일로 당사 제품들을 패키지 하는데 직면할 기술적 어려움, 그리고 당사가 Form 8K, 10K 및 10Q 양식에 따라 증권거래위원회에 제출한 보고서에서 상술한 그 밖의 위험 요소들을 포함한다. 이러한 위험들과 그 밖의 위험들로 인해서 당사가 기록할 장래 실제결과는 위에서 언급한 내용과는 실질적으로 다를 수도 있다. 본 향후예상설명은 본 보도자료 발표 당일만을 대변하는 것이며 당사는 법률에 따른 필요 외에는 새로운 정보나 장차 발생할 일 혹은 그 밖의 이유로 본 향후예상설명을 업데이트 자료를 발표하거나 수정할 어떤 의무도 지지 않는다.

자료제공: California Micro Devices Corporation

연락처: Kevin Berry, Chief Financial Officer of California Micro Devices,
+1-408-934-3144, or kevinb@cmd.com

Web site: <http://www.calmicro.com>
<http://www.spel.com>
(CAMD)